

通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2025 年度业绩网上说明会的投资者
时间	2026 年 4 月 28 日 (周二) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司出席本次年度业绩说明会的人员	董事长兼总裁石磊、董事兼副总裁夏鑫、独立董事沈小燕、副总裁兼董事会秘书蒋澍、财务总监廖洪森
投资者关系活动主要内容介绍	<p>与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的主要问题进行了答复：</p> <p style="padding-left: 2em;">1、公司产品的主要应用领域？可以对抗行业波动吗？未来发展战略是什么？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。</p> <p>公司全面开发欧美、大陆、亚太等地区的客户及市场，努力实现客户多元化，叠加广泛的产品布局优势，有利于实现多元化增长动能，可对冲行业周期性波动风险。</p> <p>公司将践行以下发展战略：1、内循环成为行业尖兵，围绕先进封装，进一步加强关键核心技术攻关；2、外循环巩固海外市场，深度参与国际竞争，大力发展建设东南亚等地的重要海外基地；3、重视兼并重组，坚持产业与投资相结合，以并购促发展，不断寻找优质的并购机会。同时，站在“十五五规划”的起点，我们也提出通富微电“十五五规划”的四个核心方向：智“算”、智“存”、智“能”、智“造”，进一步提升公司核心竞争力，实</p>

现高质量发展。谢谢！

2、长电科技公告的一季报同比增长 42%，贵公司对自己未发布的 1 季报有没有信心不掉队

尊敬的投资者，您好！感谢您对通富微电的关注。敬请关注公司一季报。谢谢！

3、你好，请问公司对于半导体行业到 2030 年的中期规划有什么明确的目标？

尊敬的投资者，您好！感谢您对通富微电的关注。“十五五”期间，公司将践行以下发展战略：1、内循环成为行业尖兵，围绕先进封装，进一步加强关键核心技术攻关；2、外循环巩固海外市场，深度参与国际竞争，大力发展建设东南亚等地的重要海外基地；3、重视兼并重组，坚持产业与投资相结合，以并购促发展，不断寻找优质的并购机会。谢谢！

4、有没可能一季度的业绩明天晚上发，那后天股市开盘还能发酵一下，我相信一季度肯定是同比增长的，让股东们开开心心过节

尊敬的投资者，您好！敬请耐心关注公司一季报内容。谢谢！

5、领导您好，请问贵公司年报里提到完成了国产 PSPI 的验证，请问是哪家的 PSPI 产品？

尊敬的投资者，您好！相关合作伙伴信息属于公司商业机密，我们无法回复，给您带来不便，敬请谅解！谢谢！

6、你好，请问 amd 这个客户对今年公司的营收增长贡献大么

尊敬的投资者，您好！感谢您对通富微电的关注。公司与 AMD 形成了“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系。未来随着 AMD 业务的持续向好与快速增长，将为公司整体营收规模提供坚实支撑与稳定保障。

7、公司的 CPU 业务占比多少

尊敬的投资者，您好！公司主要为有 CPU 封测需求的客户提供封测服务，截至 2025 年，相关业务保持良好增长。谢谢！

8、去年至现在很多集成电路细分行业硬件价格有较大上涨，公司封测毛利率与去年相比会有上升吗

尊敬的投资者，您好！感谢您对通富微电的关注。有关今年的毛利情况，请关注公司今年的定期报告。谢谢！

9、公司在和长鑫存储的 h b m 布局合作一直在持续吗？

尊敬的投资者，您好！感谢您对通富微电的关注。据了解，相关产品目前仍是国际 Memory IDM 大厂主导封测。谢谢！

10、cpo 有什么最新进展？

尊敬的投资者，您好！公司在光电合封（CPO）领域的技术研发取得阶段性进展，研发产品已通过可靠性测试，已进入量产导入阶段。谢谢！

11、贵公司现在倒装焊和先进封装占比百分之 70，请问去年倒装焊和先进封装占总营收比是多少？

尊敬的投资者，您好！感谢您对通富微电的关注。公司倒装焊等先进封装收入占比保持稳中有升。谢谢！

12、请问，跟华为有合作吗？哪些方面？

尊敬的投资者，您好！公司主营集成电路封装测试业务，公司客户资源覆盖国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业，大多数世界前 20 强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为公司客户。谢谢！

13、续断接着问：（问题提得有些多，辛苦回答） 3，公司近年业绩大增，未来分红政策是否会优化？是否有明确的分红比例或回购规划，回馈长期投资者？ 4，半导体周期波动下，公司如何平滑业绩波动？2026 年行业景气度与公司订单能见度如何？ 5，：2025 年业绩创新高，但现金流与负债率仍有压力，后续降负债、改善经营性现金流的具体措施与时间表？

尊敬的投资者，您好！3. 公司将根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）》等相关规定，提出分红方案，努力提高对投资者的回报！4. 公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。广泛的产品布局优势，有利于实现多元化增长动能，有效对冲行业周期性波动风险。5. 感谢您的关注，针对您提出的问题，公司已启动定增事项，本次定增股权融资有利于缓解公司发展过程中的资金压力；有利于提高公司偿债能力，降低财务杠杆与短期偿债风险；有利于公司降低财务费用，提高公司盈利水平。谢谢！

14、公司董事长在十四届全国人大四次会议上发言了？

尊敬的投资者，您好！公司董事长石磊先生在十四届全国人大四次会议江苏代表团审议时，围绕“加强关键核心技术攻关”主题作了发言，结合自身深耕半导体领域的实践，汇报对科技自立自强的深刻感悟。谢谢！

15、我是公司长期股东，持有 1151 天，一直坚定看好公司长期发展，多年来公司也给投资者带来了丰厚回报。作为长期持有者，想请教几个关心的问题： 1，公司在 AI/H B M/Chiplet 等先进封装上的产能规划、良率目标与客户拓展节奏？未来 2-3 年先进封装占比与毛利目标是多少？ 2，国内 AI 芯片、存储、车规级芯片的封装订单增长情况？对国内头部客户的突破与绑定有何具体规划？

尊敬的投资者，您好！1. 公司紧跟行业技术发展趋势，抓住市场发展机遇，面向未来高附加值产品以及市场热点方向，立足长远，大力开发扇外型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能；此外，积极布局 Chiplet、2D+等顶尖封装技术，形成了差异化竞争优势。2. 2025 年，公司精准把握国内模拟芯片国产化窗口，与客户形成产能与技术的战略互补，国内营收提升 20%以上，产能利用率同步优化；在电源管理芯片领域，深化与电源管理芯片头部客户合作，市场份额显著扩大，带动亿级营收增长；在汽车电子领域，车载业务在汽车智能化、电动化趋势下快速扩张，依托成熟的车载平台优势，客户覆盖数量翻番，应用场景从传统控制系统延伸至智能座舱、底盘控制等核心领域；在存储领域，存储芯片受益于景气度提升以及国内半导体供应链协同影响，营收同比大幅增长；在显示驱动领域，成功突破显示驱动两大龙头客户，产值实现两位数增长。谢谢！

16、明天一季报几点发布？

尊敬的投资者，您好！感谢您对通富微电的关注。公司预约的一季报披露时间为 4 月 30 日。谢谢！

17、公司高端封测的占比今年目标会比去年高多少？

尊敬的投资者，您好！感谢您对通富微电的关注。
我们会努力增加高端封测的营收，持续提升其占比。谢谢！

18、请问贵公司今年高端封装的占比情况？

公司提前布局先进封装产品，目前已大规模产业化生产，倒装焊等先进封装收入占比约 70%，今年也将进一步扩展市场，加大研发力度。感谢你对公司的关注！

19、请问上游材料端价格上涨以及封测设备受限是否会侵蚀公司利润，封测价格会否上涨

尊敬的投资者，您好！感谢您对通富微电的关注。公司具备较完善的产品价格管理体系，会综合考虑市场供需、生产成本、原材料价格等多方面因素来进行价格调整，最终由公司与客户根据市场化原则，协商确定封测价格。谢谢！

20、各位老总，请问按照目前的供需状态，后期与 AMD 的相关业务合作有涨价的预期？

尊敬的投资者，您好！感谢您对通富微电的关注。公司与 AMD 形成了“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系。未来随着大客户业务的持续向好与快速增长，将为公司整体营收规模提供坚实支撑与稳定保障。

21、公司除了 Amd，是否考虑与国产算力厂商合作，拓展封测业务

尊敬的投资者，您好！公司主营集成电路封装测试业务，大多数世界前 20 强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为公司客户，公司全力支持客户多元化发展，努力满足客户多样化需求。谢谢！

22、领导们好，根据 25 年报所示，投资 9.96 亿的槟城新建厂房，工程投入已达 99.42%，能简要阐述一下该项目的规划吗，包括产线上马何种封装封测技术、计划竣工时间、投产时间，以及满产后大致产值是多少？谢谢！

尊敬的投资者，您好！感谢您对通富微电的关注。槟城工厂聚焦海外市场，精准匹配全球战略。报告期内，重点提升 AI 与高算力产品封测能力，加快推进 3nm 先进工艺产品开发与先进封装能力建设，为业务发展提供核心支撑。

23、请问公司苏州、槟城、合肥等核心基地的新建 / 扩建产线，今年的产能爬坡进度是否符合公司年初预期或者存在超预期？目前相关产线良率水平如何？

尊敬的投资者，您好！IDC（国际数据公司）预测，2026 年全球集成电路封测行业将实现 11% 的增长。作为集成电路封测龙头企业，公司将积极做好各厂区新建/扩建产线的建设，提升相关产线的良率水平，努力实现超越行业平均水平的营收增速。2026 年，公司营收目标为 323 亿元，较 2025 年增长 15.68%。谢谢！

24、近期封测行业多家厂商反馈一季度产品交付周期拉长、产能全线满载，请问公司是否也出现了类似的经营情况？公司封测产品的价格是否跟随行业景气度出现了上调？

尊敬的投资者，您好！感谢您对通富微电的关注。目前公司生产经营情况正常，一季度的经营情况，请参考一季报公告。

25、请问 2026 开年以来，全球半导体及封测行业的景气度很高，AMD 和英特尔股价大涨，预期业绩也是会超预期，对公司的日常经营是否产生了正向影响？

尊敬的投资者，您好！在数字经济蓬勃发展的背景下，人工智能、数据中心、云计算、物联网等新兴应用场景不断涌现，为集成电路封测行业增长注入多元化动力。IDC（国际数据公司）预测，2026 年全球集成电路封测行业将实现 11% 的增长。作为集成电路封测龙头企业，公司将积极承接大客户订单需求，努力实现超越行业平均水平的营收增速。2026 年，公司营收目标为 323 亿元，较 2025 年增长 15.68%。谢谢！

26、请问公司 2026 年的研发投入、各项费用支出，是否保持在公司年初规划的合理区间内？有无出现大额的非经常性费用支出？

尊敬的投资者，您好！感谢您对通富微电的关注。公司目前生产经营正常，敬请关注公司定期公告信息。

27、请问，公司目前未达产的产能规划是多少？具体产品是什么？

尊敬的投资者，您好！为了实现公司 2026 年 323 亿元的营收目标，并为今后的生产经营做好准备，公司及下属控制企业计划 2026 年在设施建设、生产设备、IT、技术研发等方面投资共计 91 亿元。具体实施过程中，会根据市场需求调整。谢谢！

28、贵公司一季度的汇兑损失大吗？产能利用率达到多少

尊敬的投资者，您好！感谢您对通富微电的关注。请参见公司一季度公告。

29、请问公司跟英特尔有合作吗 英特尔的 CPU 业务是否给贵公司带来收益

尊敬的投资者，您好！公司暂无与英特尔的相关合作。谢谢！

30、贵公司今年的产能利用率怎样，能否做到满产

尊敬的投资者，您好！感谢您对通富微电的关注。公司的产能利用率会

随着市场供需情况、客户结构情况的变化而相应变化，公司目前生产经营正常。

31、公司 2026 年在手订单量有多少

尊敬的投资者，您好！公司目前生产经营正常。2026 年，公司营收目标为 323 亿元，较 2025 年增长 15.68%。谢谢！

32、贵公司的封测产能利用率是多少？去年封测单价涨价了吗？今年涨价了吗？

尊敬的投资者，您好！感谢您对通富微电的关注。公司的产能利用率会随着市场供需情况、客户结构情况的变化而相应变化，公司目前生产经营正常；产品单价，取决于产品结构、市场供需等因素。谢谢！

33、请问贵公司跟英特尔有 CPU 方面的合作吗或者有哪些方面存在合作

尊敬的投资者，您好！公司暂无与英特尔的相关合作。谢谢！

34、你好，请问公司目前与 CPU 相关的业务开展如何？在主营业务收入中的占比是多少？下一步如何规划 CPU 业务与其他业务的平衡？

尊敬的投资者，您好！感谢您对通富微电的关注。公司主要为有 CPU 封测需求的客户提供服务，业务保持良好增长，并会根据公司战略、市场需求，保持动态平衡。

35、amd 对通富微电的业绩影响

尊敬的投资者，您好！感谢您对通富微电的关注。公司与 AMD 形成了“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系。公司是 AMD 最主要的封测供应商，占其相关产品的 80%以上，未来随着大客户业务的持续向好与快速增长，将为公司整体营收规模提供坚实支撑与稳定保障。

36、领导您好，请问贵公司 2025 年度先进封装业务所占的比例是多少？目前先进封装各业务的比例分别是多少？

尊敬的投资者，您好！公司倒装焊等先进封装产品已大规模产业化生产，倒装焊等先进封装收入占比约 70%。谢谢！

37、2026 年公司所在的半导体领域，是否高利润增长点领域已经出现，公司是如何抓住该机遇的

尊敬的投资者，您好！2026 年，AI 算力需求预计继续扩张，并逐步向更广泛应用场景延伸，包括机器人、自动化、边缘计算及智能制造等领域。先进封装仍将是性能提升的重要路径，随着高带宽内存堆叠数量持续增加、

	<p>chiplet 架构进一步普及，封装复杂度将持续提升。总体而言，2026 年封测行业主线延续 AI 驱动的先进封装高景气，技术复杂度与系统集成度进一步提升，封测环节在芯片整体性能提升中的战略地位持续强化。谢谢！</p> <p>38、第一季度业绩怎么样？</p> <p>尊敬的投资者，您好！感谢您对通富微电的关注。公司 2026 年 1 季度业绩，请参见公司公告。</p> <p>39、领导，您好！我来自四川大决策 请问，定增投向的存储芯片、汽车电子、晶圆级、高性能计算封测产能，预计何时能够形成收入贡献？对应的客户是谁？</p> <p>尊敬的投资者，您好！感谢您对公司定增事项的关注，定增有关具体信息，请参阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。关于本次股权融资的后续进展，敬请关注公司今后披露的相关公告。谢谢！</p> <p>40、贵公司 2026 年 1 季度业绩披露在最后一天，是不是爆雷了</p> <p>尊敬的投资者，您好！感谢您对通富微电的关注。公司 2026 年 1 季度业绩，请参见公司公告。</p>
附件清单（如有）	
日期	2026-04-28